

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-003

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月22日召开第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币9亿元（含9亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年2月23日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。根据公司的资金使用安排，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8.4亿元。

2023年11月29日，公司提前归还暂时补充流动资金的募集资金人民币1.4亿元，具体内容详见《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-172）。

2024年1月18日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币7亿元归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

截至本公告披露日，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024年1月19日